

HOLOPLOT



HOLOPLOT X1

Modul 96

参数表 / 版本 1.1 中文版

X1 Modul 96 参数表



配置

双层矩阵排列

低频层	18个5英寸锥形驱动单元，位于独立的双端口腔体中
高频层	78个1.3英寸软球顶高音扬声器，集成导波管

最大声压级

(针对优化的平行波束配置)¹

低频层	142 dB ²
高频层	152 dB ²

频率响应

±3 dB	100 - 18,000 Hz
-10 dB	85 - 20,000 Hz

波束成形能力:³

HOLOPLOT 三维立体音频波束成形技术

波束数量	每个 X1 矩阵阵列最多可并行生成 13 个波束及转向角： · 8 个完全用户可配置的参数波束和虚拟声源 · 5 个为预定义观众区域覆盖的波束
垂直	转向角和开角可由用户调整(以 0.1° 为步长)/ 由 HOLOPLOT 算法定义
水平	转向角和开角可由用户调整(以 0.1° 为步长)/ 由 HOLOPLOT 算法定义

¹ 最大声压级能力取决于波束配置和阵列大小，应使用 HOLOPLOT Plan 进行评估。

² 峰值电平在自由场条件下使用带通粉红噪声(峰值因素为 4)参照 1 米处测量。

³ 波束成形能力取决于阵列大小，应使用 HOLOPLOT Plan 进行评估。

功放

类型	6 个 16 通道数字功率放大器模块
最大输出功率 ⁴	HF: 78x 240 Wpk LF: 18x 500 Wpk

处理

类型	高性能现场可编程门阵列(FPGA)用于计算 HOLOPLOT 专用的数字信号处理算法, 实现三维立体音频波束成形和波场合成。 双核 ARM® Cortex™-A9 处理器运行 HOLOPLOT OS, 基于 Linux 的分布式音频操作系统。
DSP 通道	96
计算	7600 个参数均衡(Parametric EQ)频段和超过 1100 个有限脉冲响应(FIR)滤波器, 具有超过 430000 个滤波抽头。

功耗

休眠模式	120 W
空闲	300 W
连续运行	650 W
高性能	1450 W

电子组件连接器

控制/音频	4x etherCON Cat 6A (RJ45) for Control and Audio-over-IP (RAVENNA, Dante®, AES67) 2x etherCON Cat 6A (RJ45) for HoloLink 2x etherCON Cat 6A (RJ45) for SubLink
电源	1x Amphenol HP-3-MDQ for AC Power IN (115 - 240 V AC, 50 - 60 Hz) 1x Amphenol HP-3-MDGQ for AC Power OUT (208 - 240 V AC, 50 - 60 Hz)

Phoenix

⁴ 波束成形能力取决于阵列大小, 应使用 HOLOPLOT Plan 进行评估。

物理特性

尺寸	800 mm x 600 mm x 457 mm (± 2.5 mm)
重量	100 kg

材料和颜色

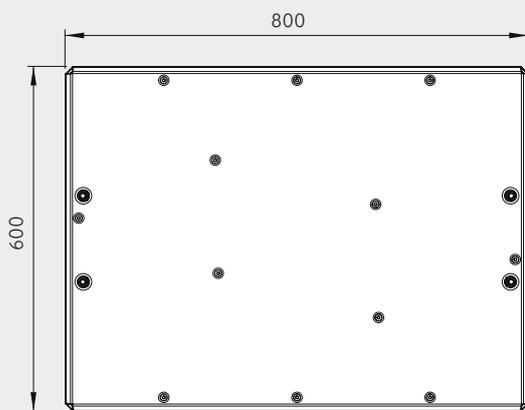
扬声器箱体	玻璃纤维增强聚碳酸酯, 阻燃, 轻微纹理的黑色饰面 黑色 (RAL 9005)
电子组件	铝合金, 黑色粉末涂层 (RAL 9005)
保护网罩	六角形穿孔钢, 配有疏水、防潮和防尘的声学布, 黑色 (RAL 9005)

环境条件

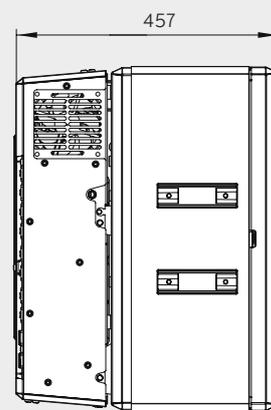
设备状态	温度	湿度	海拔
包装运输	-20 °C to +60 °C	to 90% at +60 °C	可达 12000 米(平均海平面)
运行环境	+10 °C to +45 °C	to 70% at +45 °C (无冷凝)	可达 2000 米(平均海平面)

机械细节

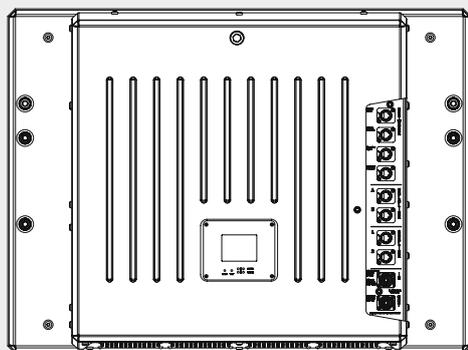
所有测量值均以毫米为单位



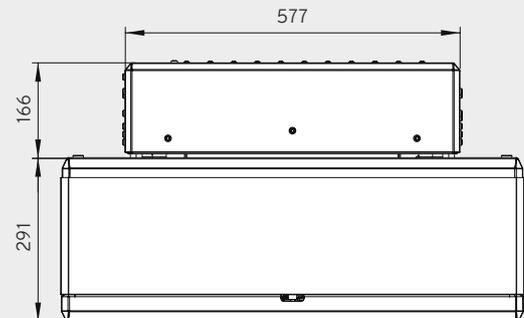
正面



侧面



背面



顶视